



Carl Zeiss: Richtfest für die Erweiterung des modernsten Zentrums für Lithografie-Optik weltweit

Carl Zeiss: Richtfest für die Erweiterung des modernsten Zentrums für Lithografie-Optik weltweit
Flächen nahezu verdoppelt - Nutzung ab Frühjahr 2013
OBERKOCHEN, 18.10.2012. Carl Zeiss hat einen wichtigen Meilenstein bei einem seiner Infrastrukturprojekte erreicht: Für die neuen Produktionshallen und Bürogebäude des Unternehmensbereichs Halbleitertechnik im Interkommunalen Gewerbegebiet Oberkochen/ Königsbronn feierte das Unternehmen mit Partnern und Mitarbeitern das Richtfest. "Gemeinsam mit dem Neubau des Unternehmensbereichs Medizintechnik und weiteren Gebäuden ist die Erweiterung das größte Bauprojekt in der Geschichte von Carl Zeiss", erklärt Dr. Michael Kaschke, Vorstandsvorsitzender von Carl Zeiss. "Mit dieser modernen Infrastruktur schaffen wir die Grundlage, auch zukünftig den Anforderungen der globalen Märkte gerecht zu werden." Insgesamt wird Carl Zeiss in den kommenden Jahren rund 500 Millionen Euro in den weiteren Ausbau der deutschen Unternehmensstandorte investieren. Für das Werk der Halbleitertechnik entstehen momentan neue Fertigungsräume und Bürogebäude. Bis zum kommenden Jahr wird sich die Nutzfläche nahezu verdoppeln. Ein großer Teil wird dabei zu Reinraumfläche ausgebaut, die höchste Anforderungen erfüllt. "Im Unternehmensbereich Halbleitertechnik arbeiten wir an verschiedenen Hightech-Produkten zur Nutzung im Halbleitertechnik-Geschäft", sagt Dr. Hermann Gerlinger, der im Vorstand der Carl Zeiss AG für den Unternehmensbereich Halbleitertechnik zuständig ist. "Neben unseren bewährten, sehr erfolgreichen Produkten fertigen wir nun auch Optiken der EUV-Technologie." Die optische Lithografie mit extrem ultraviolettem Licht (EUV) markiert den nächsten Technologiesprung in der Mikrochipfertigung. Sie ermöglicht Strukturen von unter 20 Nanometern und damit die Herstellung noch leistungsfähigerer Chips. Gerlinger betont: "Wir werden diesen neuen Markt dank der zusätzlichen Produktionskapazitäten in unserem Werk erschließen." Im September 2011 hatten die Bauarbeiten auf dem Gelände des Unternehmensbereichs Halbleitertechnik in Oberkochen begonnen. "Seit der Grundsteinlegung im Jahr 2000 haben wir hier in mehreren Bauabschnitten das modernste Werk für Lithografie-Optik weltweit geschaffen. Die aktuelle Werkserweiterung ist ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung des Unternehmensbereichs Halbleitertechnik", so Hellmuth Aeugle, Leiter Business Services Infrastructure von Carl Zeiss. Die besonderen Ansprüche des Halbleitertechnikbereichs spiegeln sich zum Beispiel bei der Fertigung einer schwingungsfreien Bodenplatte wider: In mehr als 1.000 Fahrten transportierten Lkw in drei Tagen non-stop Material auf die Baustelle. Für rund 18.000 Tonnen Beton wurde sogar ein eigenes Betonwerk aufgebaut. Bei der Fertigung von Halbleitertechnik-Equipment ist die Vermeidung von Schwankungen essenziell. Das Richtfest für die Erweiterung des Unternehmensbereichs Halbleitertechnik feierte Carl Zeiss mit insgesamt mehr als 1.500 Mitarbeitern und Partnern. Der Bezug der neuen Gebäude ist für Frühjahr 2013 geplant.
Jörg Nitschke
Konzernpressesprecher
Carl Zeiss AG
Tel.: +49 7364 20-3242
Fax: +49 7364 20-3122
E-Mail: j.nitschke@zeiss.de
http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=511321

Pressekontakt

Carl Zeiss AG

73447 Oberkochen

j.nitschke@zeiss.de

Firmenkontakt

Carl Zeiss AG

73447 Oberkochen

j.nitschke@zeiss.de

Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage